

**Bruxelas, 9 de setembro de 2025
(OR. en)**

**12656/25
ADD 1**

**ENV 815
MI 635
DELECT 125**

NOTA DE ENVIO

de:	Secretária-geral da Comissão Europeia, com a assinatura de Martine DEPREZ, diretora
data de receção:	8 de setembro de 2025
para:	Thérèse BLANCHET, secretária-geral do Conselho da União Europeia
n.º doc. Com.:	C(2025) 5939 final - Annex
Assunto:	ANEXO da Diretiva Delegada da Comissão que altera a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção aplicável ao chumbo em soldas com alta temperatura de fusão

Envia-se em anexo, à atenção das delegações, o documento C(2025) 5939 final - Annex.

Anexo: C(2025) 5939 final - Annex



COMISSÃO
EUROPEIA

Bruxelas, 8.9.2025
C(2025) 5939 final

ANNEX

ANEXO

da

Diretiva Delegada da Comissão

**que altera a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a
uma isenção aplicável ao chumbo em soldas com alta temperatura de fusão**

ANEXO

No anexo III da Diretiva 2011/65/UE, o ponto 7 a) é substituído pelo seguinte:

«7 a)	Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %)	Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 30 de junho de 2027.
7 a)-I	Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) para interligações internas para fixação de pastilhas ou de outros componentes juntamente com uma pastilha numa montagem de semicondutores com correntes, estacionárias ou transitórias/de impulsos, iguais ou superiores a 0,1 A ou tensões de bloqueio superiores a 10 V, ou rebordos de pastilha superiores a 0,3 mm × 0,3 mm	Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027.
7 a)-II	Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) para ligações integrais (ou seja, internas e externas) de pastilhas em componentes elétricos e eletrónicos, se estiverem preenchidas todas as seguintes condições: — a condutividade térmica do material curado/sinterizado é superior a 35 W/(m*K), — a condutividade elétrica do material curado/sinterizado é superior a 4,7 MS/m, — temperatura de fusão da solda é superior a 260 °C	Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027.
7 a)-III	Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) nas juntas de soldadura de primeiro nível (ligações internas ou integrais — ou seja, internas e externas) para o fabrico de componentes de modo a que a subsequente montagem de componentes eletrónicos	Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de

	em subconjuntos (ou seja, módulos, placas de subcircuitos, substratos ou soldadura ponto a ponto) com uma solda secundária não provoque o refluxo da solda de primeiro nível. Esta subentrada exclui as aplicações de «pastilha» e a selagem hermética.	dezembro de 2027.
7 a)-IV	Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) nas juntas de soldadura de segundo nível para a fixação de componentes a placas de circuitos impressos ou a armações de chumbo: 1. em esferas de soldadura para a fixação de redes de esferas de cerâmica (BGA), 2. em sobremoldagens plásticas de alta temperatura (superior a 220 °C)	Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027.
7 a)-V	Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) como material de selagem hermética entre: 1. um pacote ou ficha cerâmicos e um invólucro metálico, 2. pontas de componentes e uma subparte interna	Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027.
7 a)-VI	Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) para estabelecer ligações elétricas entre componentes de lâmpadas refletoras incandescentes para aquecimento por infravermelhos, lâmpadas de descarga de alta intensidade ou lâmpadas de forno	Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027.
7 a)-VII	Chumbo em soldas com alta temperatura de fusão (isto é, ligas com teor ponderal de chumbo igual ou superior a 85 %) para transdutores áudio cuja temperatura máxima de funcionamento seja superior a 200 °C	Aplica-se a todas as categorias (com exceção das aplicações abrangidas pela isenção 24 do presente anexo) e caduca a 31 de dezembro de 2027.»

--	--	--